

半导体材料的检测与测试，冲击冷热箱试验

产品名称	半导体材料的检测与测试，冲击冷热箱试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

半导体材料的检测与测试，冲击冷热箱试验

半导体器件封装内部结构分析，包括器件封装内部每层结构（芯片+焊接层+热沉等）的热阻和热容参数； 半导体器件老化试验分析和封装缺陷诊断，帮助用户准确定位封装内部的缺陷结构； 材料热特性测量（导热系数和比热容）； 接触热阻测量，包括导热胶、新型热接触材料的导热性能测试。四. 测试方法——基于电学法的热瞬态测试技术1.测试方法——电学法寻找器件内部具有温度敏感特性的电学参数，通过测量该温度敏感参数（TSP）的变化来得到结温的变化。TSP的选择：一般选取器件内PN结的正向结电压。2.测试技术：热瞬态测试

当器件的功率发生变化时，器件的结温会从一个热稳定状态变到另一个稳定状态，T3Ster将会记录结温瞬态变化过程（包括升温过程与降温过程）。

一次测试，既可以得到稳态的结温热阻数据，也可以得到结温随着时间的瞬态变化曲线。瞬态温度响应曲线包含了热流传导路径中每层结构的详细热学信息（热阻和热容参数）。